

【11】證書號數：M581717

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 08 月 01 日

【51】Int. Cl. : G06F1/20 (2006.01) H05K7/20 (2006.01)
F28F9/26 (2006.01)

新型

全 7 頁

【54】名稱：散熱裝置及應用散熱裝置的主機板模組

【21】申請案號：108205764 【22】申請日：中華民國 108 (2019) 年 05 月 09 日

【72】新型創作人：葉俊德 (TW)；周家民 (TW)；羅時英 (TW)

【71】申請人：微星科技股份有限公司 MICRO-STAR INT'L CO., LIMITED.
新北市中和區立德街 69 號
大陸商恩斯邁電子(深圳)有限公司 MSI COMPUTER (SHENZHEN) CO., LTD.

中國大陸

【74】代理人：李文賢

【57】申請專利範圍

1. 一種散熱裝置，包含：
一散熱背板組件，包含一背板本體及複數個散熱接腳，該等散熱接腳由該背板本體向外延伸出，各該散熱接腳包含一定位孔；以及
一風扇，組接於該散熱背板組件上，該風扇包含複數個連接部，分別連接於該等散熱接腳的該定位孔。
2. 如請求項 1 所述之散熱裝置，其中該等散熱接腳與該背板本體是一體成型。
3. 如請求項 1 所述之散熱裝置，其中該等散熱接腳組接於該背板本體之上。
4. 如請求項 3 所述之散熱裝置，其中該散熱背板組件更包含二連接塊，該二連接塊分別組接於該背板本體的兩側，且各該連接塊分別與該等散熱接腳中的至少兩個組接連接。
5. 如請求項 1 所述之散熱裝置，其中該散熱背板組件更包含一散熱架，該散熱架與該背板本體組接，該等散熱接腳由散熱架延伸出。
6. 如請求項 1 所述之散熱裝置，其中該等散熱接腳與該風扇的總厚度小於 2 公分。
7. 一種主機板模組，包含：
一主機板本體；以及
一散熱裝置，包含：
一散熱背板組件，設置於該主機板本體一第一表面上，該散熱背板組件包含一背板本體及複數個散熱接腳，該等散熱接腳由該背板本體向外延伸出，各該散熱接腳包含一定位孔；以及
一風扇，組接於該散熱背板組件上，並電性連接該主機板本體，該風扇包含複數個連接部，分別連接於該等散熱接腳的該定位孔。
8. 如請求項 7 所述之主機板模組，更包含一中央處理器，連接於該主機板本體的一第二表面上，並與該主機板本體電性連接，該中央處理器對應於該背板本體，且該第一表面與該第二表面是該主機板本體的相對二表面。
9. 如請求項 8 所述之主機板模組，更包含一第二風扇，設置於該中央處理器上，且電性連接該主機板本體，該第二風扇與該風扇位於該中央處理器的相對二側。
10. 如請求項 7 所述之主機板模組，其中該等散熱接腳與該風扇的總厚度小於 2 公分。

(2)

11. 如請求項 7 所述之主機板模組，其中該等散熱接腳與該背板本體一體成型。
12. 如請求項 7 所述之主機板模組，其中該等散熱接腳組接於該背板本體之上。
13. 如請求項 11 所述之主機板模組，其中該散熱背板組件更包含二連接塊，該二連接塊分別組接於該背板本體的兩側，且各該連接塊分別與該等散熱接腳中的至少兩個組接連接。
14. 如請求項 7 所述之主機板模組，其中該散熱背板組件更包含一散熱架，該散熱架與該背板本體組接，該等散熱接腳由散熱架延伸出。

圖式簡單說明

圖 1 為散熱裝置的分解示意圖。

圖 2 為圖 1 中散熱背板組件第一實施例的示意圖。

圖 3 為圖 1 中散熱背板組件第二實施例的分解示意圖。

圖 4 為圖 1 中散熱背板組件第三實施例的分解示意圖。

圖 5 為散熱背板組件第四實施例的分解示意圖。

圖 6 為主機板模組的分解示意圖。

圖 7 為主機板模組另一表面的立體示意圖。

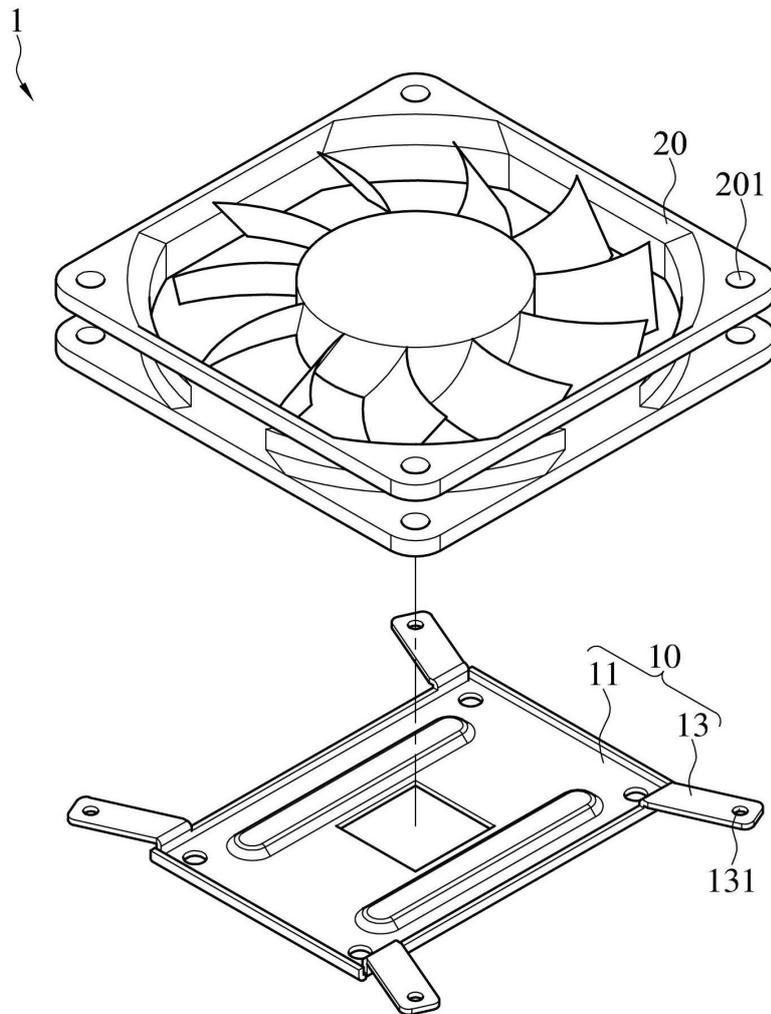


圖 1

(3)

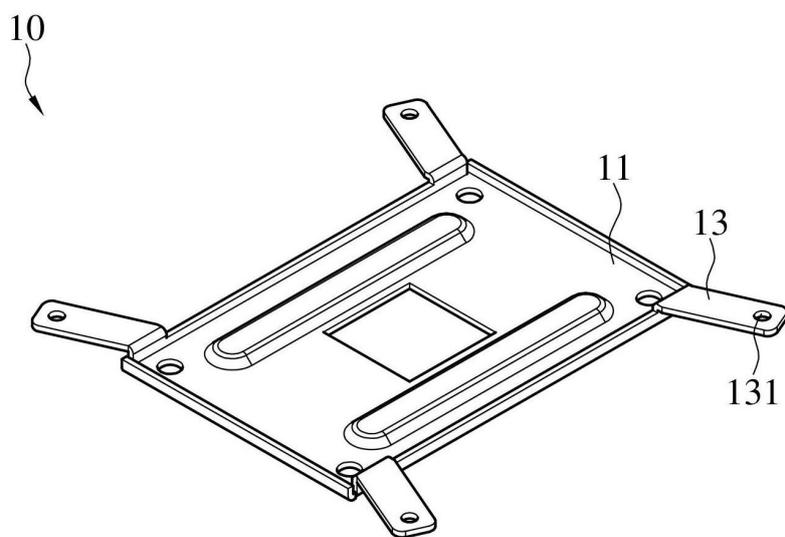


圖2

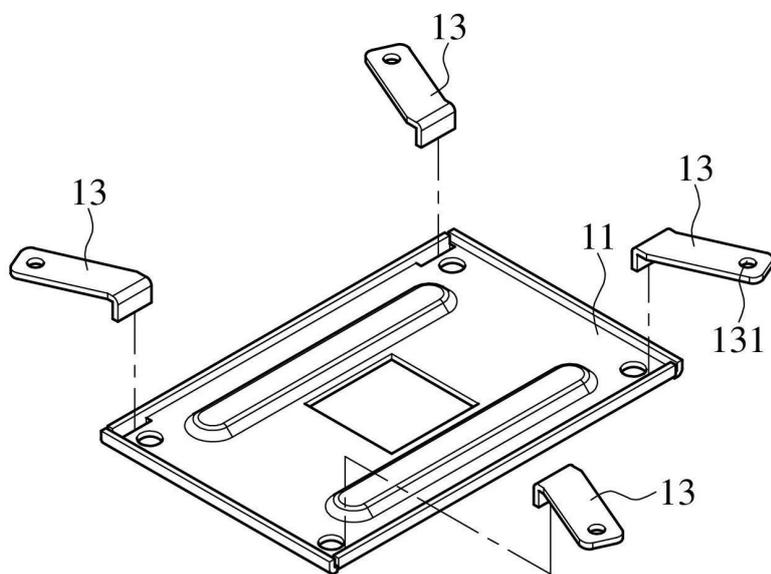


圖3

(4)

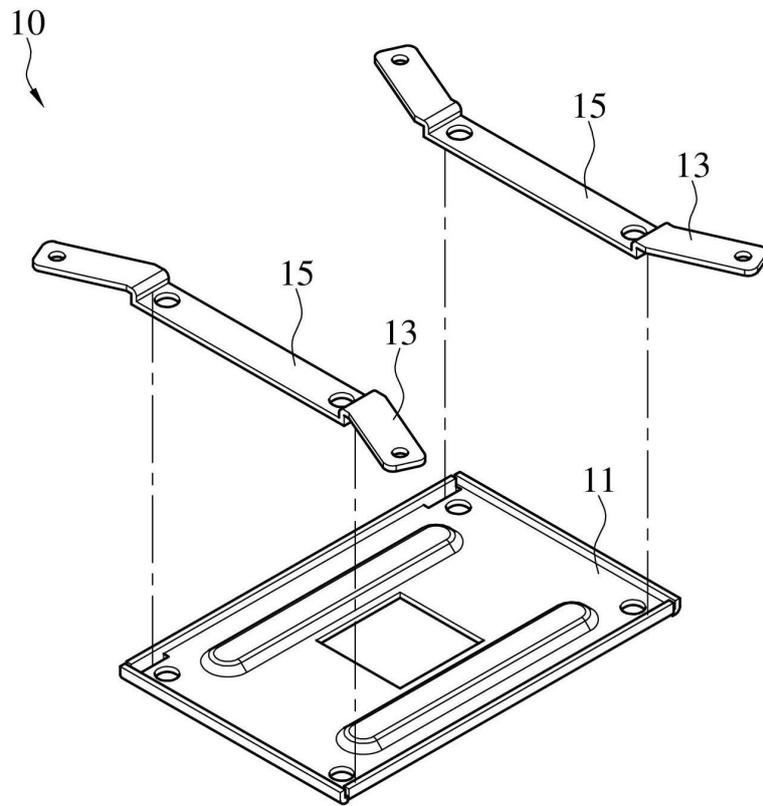


圖4

(5)

100

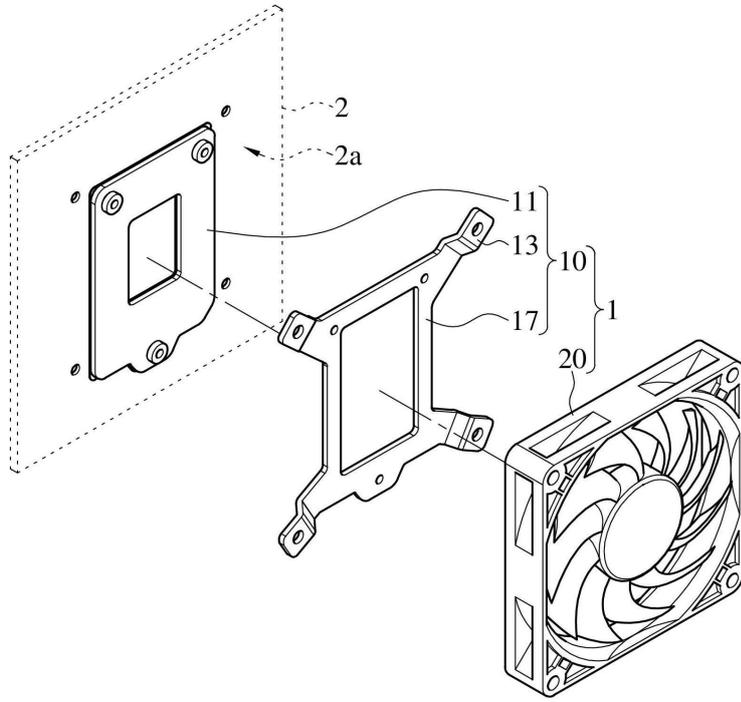


圖5

(6)

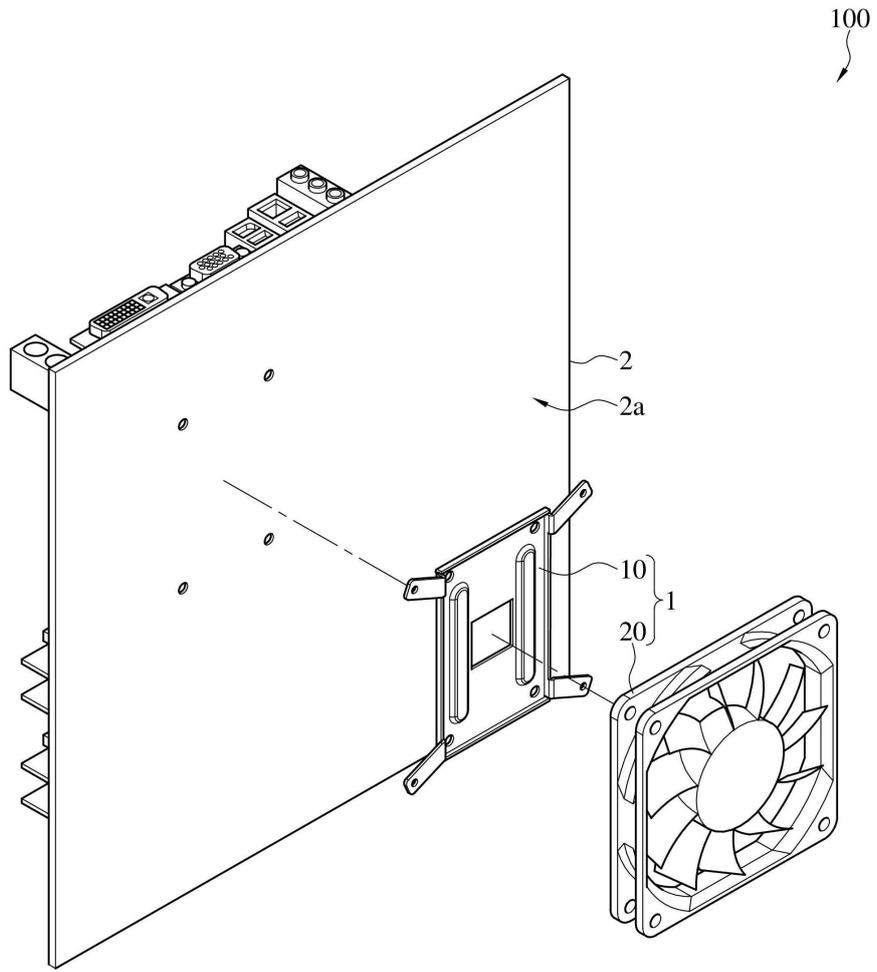


圖6

(7)

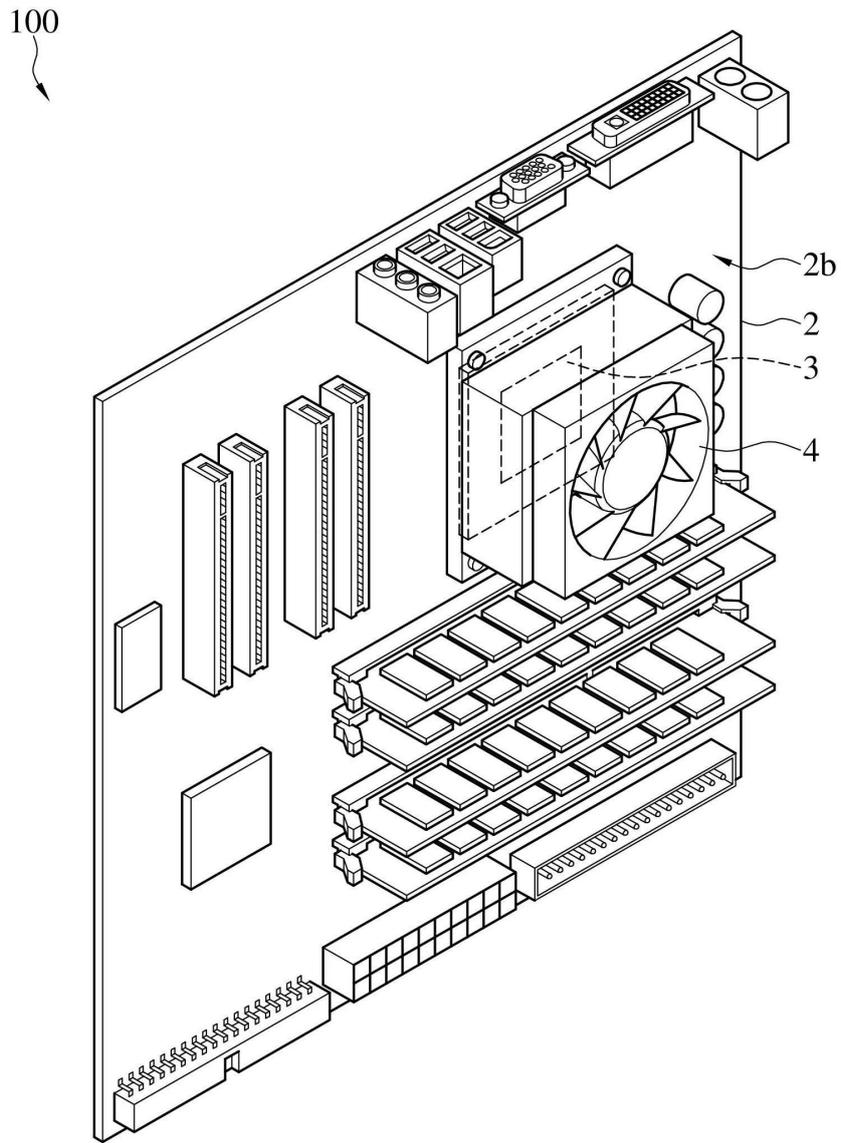


圖7